

LAGENAUFBAU HDI (Standard)
HDI08_1+6+1_1,60_35 **8 - Lagen**
Kerne: 0,30 mm Cu 35/35 μ m



WE-Artikel Nr.: [Yellow box] **1 + 6 + 1**

KUNDE: [Yellow box]

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE					[μ m]	[μ m]	
	TOP/VS			Folie	12 μ m	1)	12	
						1 x 1080	60	
	2				35 μ m		33	
				0,300 mm			300	
	3				35 μ m		33	
						1 x 1080 1 x 2116	174	
	4				35 μ m		33	
			0,300 mm			300		
	5			35 μ m		33		
					1 x 2116 1 x 1080	174		
	6			35 μ m		33		
			0,300 mm			300		
	7			35 μ m		33		
					1 x 1080	60		
	BOT/RS		Folie	12 μ m	1)	12		

				1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 μ m			
Gesamtdicke Material:						1590	
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)							

MATERIALDICKE:	1,60	+/-	0,13	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,69	+/-	0,16	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,75	+/-	0,18	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		
Erstellt am 25.04.2006	von S. Keller	Geprüft am 04.05.2006	von M.Kress	Freigegeben am 25.04.2006	von R. Schönholz	Revision 00	Seite: 1+